



ZJ-I导热垫片说明书

ZJ-I是一款纯金属导热片，通过形变充分填充界面，导热片与界面会产生良好的接触后降低接触热阻，专为高热流密度功率器件而设计，可直接当垫片使用满足不同的使用环境。

主要优势

- 导热率为传统硅油基材料的5-10倍，性能优势明显；
- 物化性质稳定，无毒无害，不易挥发，更适合高温、高热流场合的长期应用；
- 长期使用无有机物挥发，不污染光学器件，在激光器等光学器件上应用为同类产品最佳选择，具有排他性优势；
- 耐高温，远高于现有热界面材料；
- 在浸没式环境的有机溶液中亦可安全使用，兼容所有冷却液。

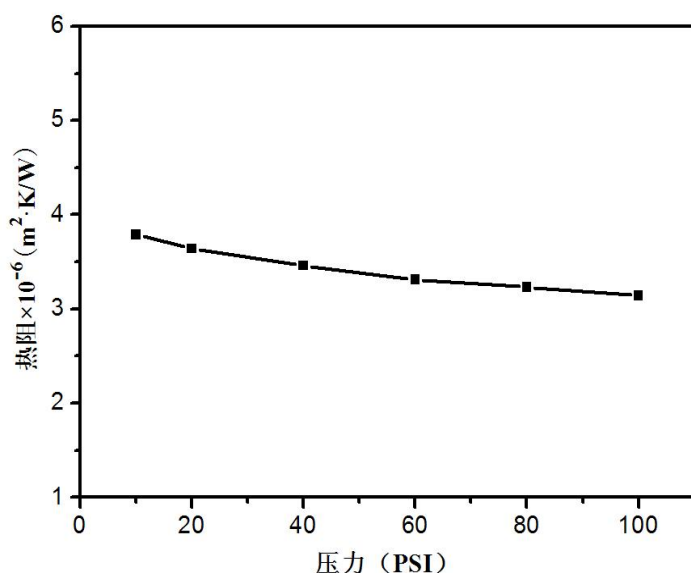


产品物性（符合RoHS规范）

型号	ZJ-I	单位	检测标准
成分	铋基合金	-	-
颜色	亮银色	-	目测
厚度	≥0.05	mm	-
热导率	≥60	W/m·K	ASTM D5470
工作温度	-50~500	°C	-
密度	7.9	g/cm ³	GB/T 1423-1996
电阻率	8.3×10 ⁻⁸	Ω·m	GB/T 6146-2010
挥发率	< 0.001%	-	-
粘度	6000(熔后)	mPa.s	ASTM D3835
熔点	60	°C	GB/T 1425-1996

**可以根据客户要求（熔点、厚度等具体参数）定制产品。（厚度≥0.05mm）

性能测试数据（热阻与压力）



使用说明

- 直接放置使用方式
- 将热源与散热器接触表面清洗干净，将导热片裁剪成与热源一样的尺寸形状
- 置于热源上中心位置，压紧散热器，推荐施加压力≥50PSI
- 标准厚度0.1mm通过超塑性形变到0.08mm充分填充界面，导热片与界面会产生良好的热接触。

储存

在未开包装条件下常温、避光储存，建议在半年内使用（未开包装条件下）